

株式会社アドバンテスト

2025年3月期(2024年度)第2四半期決算説明会 質疑応答要旨

2024年10月30日(水)

[FY24 下期見通し - SoC テスタ]

- Q1: SoC テスタ売上について、2024 年度下期は上期比で減少する計画を示された。説明の中で御社の生産能力や調達に言及されていたが、現時点で何がボトルネックになっているのか。また、下期の売上予想にどの程度の上振れ余地があるか。
- A1: 現時点で著しいボトルネックが発生しているわけではない。当社は過去のサプライチェーンの混乱を教訓にし、慎重にサプライチェーン全体の健全化を進め、着実に顧客の要求に応えるよう取り組んでいる。
- 今上期の売上は、HPC 用半導体向けテスト項目増加によりSoCテスタ需要が増え、とても好調だった。下期の売上水準は、為替想定を踏まえると、上期とほぼ同等と見ている。アップサイドもあるかもしれないが、テスト項目の増加は、顧客にとっても当社にとっても予測困難。その中で当社製品の納入時期を早めることは、対応していくもののチャレンジングでもある。
- Q2: SoC テスタの下期の売上計画において、3Q と 4Q の売上はどちらに比重がある前提となっているのか。また、2Q の 1,000 億円を超える売上計上は、9 月にかけて大きく納入が進んだものか。
- A2: 不確実性が高いものの、3Q、4Q で大きな段差ができるとは思っていない。7~9 月におけるテスタ売上も、毎月コンスタントに出荷台数を積み上げる努力の結果で、9 月に急増したわけではない。半導体の組み立て能力や当社製品含め様々な装置の納入予定など、顧客にとって全体のサプライチェーンにおける変動要因は多い。彼らの生産計画の変動により、当社に対するテスタ要求納期も変動している状況である。
- Q3: SoC テスタの下期売上の考え方についてお聞きしたい。3Q、4Q が 700 億円強になりそうと理解した。一方でハイエンド SoC のテスタ需要に関して、現時点で 2Q に前倒し納入しすぎたことで下期にスローダウンする動きはあるのか。
- A3: 1Q は一気にテスト項目が増加したが、その一部は今後も続くと考え。こういった変曲点の中で、新たな半導体の上市を背景としたテストタイムの長時間化という要素を踏まえると、顧客内のテストキャパシティが現状で十分かどうかは見極め難い。とはいえ、今後 AI 半導体において、レティクルリミットの課題、IO チップのチップレット化、バスの新アーキテクチャへの進展などといった半導体の複雑性の上昇により、テストタイム短縮が実現しにくくなると見込んでいる。また、複雑な半導体は販売単価が高く、不良による廃棄コストを抑えるため、顧客のテストに対する意欲は強い。

これらは数年前、または一年前でさえも、なかったことだ。足元、半導体の複雑性の新たな波がテスト項目とテストタイムをけん引している。半導体の生産数量よりも、半導体の複雑性がけん引するテスト項目増加といったことによるテスト需要の増加の影響がはるかに大きい。また、テストタイムという要素に加えて、テスト需要をけん引する要素として、品質保証と信頼性の強化という側面もある。

[FY25 テスタ需要見通し - SoC テスタ]

- Q4: 2025 年度の SoC テスタ需要見通しを教えてください。GPU の高速・高性能化、AI 用 ASIC などがさらなるテスト需要をけん引すると期待している。
- A4: 現時点では、来年半ばまでのテスト需要は堅調で、注意は必要だが楽観的に見ている。来期のビジビリティは限定的で、テスト市場規模がどの程度拡大するかを予測することはとても難しい。特に AI 用半導体については、テストタイムやテスト項目の変動を予測していくものの、次世代 SoC 半導体のアーキテクチャーを鑑みれば、より一段と複雑性が増し、テスト項目が増えると考えることが妥当と思う。

[CY25 半導体テスト市場見通し]

- Q5: SoC、メモリ別に暦年 2025 年の半導体テスト市場規模見通しを教えてください。
- A5: 現在、市場規模と成長率の見極めをしている段階。定量的な見通しについては来年までお待ちいただきたい。SoC テスタ市場は、半導体の複雑性が増すことでテスト需要が拡大するだろう。AI 関連 ASIC メーカーのプレゼンスも高まっている。AI 関連 ASIC メーカーは、いわゆる「マグニフィセント・セブン」各社と連携していて、生産能力拡大を図っている。これがテスト市場規模を押し上げる要因になると考えられる。メモリ・テスト市場は HBM (High Bandwidth Memory) のスタック数増加などアーキテクチャーの変化があり、テスト需要に影響を及ぼすだろう。

[リードタイム - SoC テスタ]

- Q6: SoC テスタのリードタイムはどのくらいか。
- A6: 当社の標準リードタイムは 3 か月程度だが現時点では約 3~6 か月。ただ、半導体のテストタイム、テスト項目増加などによる予測困難なテスト需要増加が起こる。それに対して迅速に対応することはチャレンジングだが、さらに社内でのオペレーション能力を強化し、顧客のさらなるテスト能力増強のトレンドに追随できるように努める。

[R&D 投資額および、今後の市場シェア推移]

- Q7: 競合他社は、御社とのギャップを縮めるため R&D 投資を強化しているようだが、来年にかけての市場シェア変動リスクをどのように認識しているか。

A7: R&D 投資は十分に行ってきており、顧客のロードマップを見越した技術開発をしている。売上拡大に伴い、対売上比率は下がる可能性はあるものの、絶対額が下がるとは限らない。これまで、顧客との関係性を緊密にして開発を継続してきたことが奏功し、近年における業績に貢献した R&D のヒット率は高まっている。市場シェアについては、第 3 期中期経営計画(MTP3)で掲げた 58%以上というターゲットを下げる必要はないと考えている。

[市場シェア]

Q8: 御社の市場シェアについて。今年 6 月に発表された MTP3 で「58%以上」という目標を示された。御社は SoC テスタ市場で競合他社よりも早いペースで成長しているので、少なくとも現時点ではこのシェア目標を上回る推移と認識して良いか。

A8: はい。

[需要見通し- SLT(システムレベルテスト)]

Q9: SLT について、コンピューティングと車載向けの需要が出てきたとのことですが、現在その 2 点のアプリケーションが SLT の中で占める割合と、3 年後の市場規模見通しを教えてください。

A9: 当社の SLT 事業はスマートフォン関連向けが主領域であり、足元は低調である。なお、当社は同市場で良好な市場ポジションを確保しており、顧客開拓も進んでいる。新たに、コンピューティング市場への拡販も視野に入れている。GPU/ASIC メーカーが歩留まり向上を図るため、バーンインと SLT を組み合わせて評価する動きもある。この領域における半導体は相対的にかなり高価であり、顧客は SLT を活用した歩留まり向上に意欲的である。さらに車載領域では、コンピューティング機能がインフォテイメント、コックピットセンシング、ADAS(先進運転支援システム)等に搭載され、高性能半導体のニーズが高まる。足元の SLT 事業規模はまだ大きくないが、将来の見通しについては自信を持っている。

SLT 市場規模の試算は難しい。内製ソリューションを有している顧客がいることも市場規模試算を困難にさせる要因である。しかし、SLT のアプリケーション領域は拡大が見込めるため、市場は確実に成長するだろう。

[HPC/AI テスト項目]

Q10: 今年度 2 回目の上方修正となったが、この要因はテスト項目の増加など、半導体あたりのテスト負荷がさらに増えたからか。もしくは、御社のテスタ納入の前倒しによるものか。前回の上方修正は、主に HPC/AI 向け半導体のテスト項目が想定よりも増えたことが理由だと認識している。

A10: 今回の上方修正は、今年 7 月以降、顧客要求納期に対応すべく部材調達を加速させ、当初の見込みよりも供給能力の拡大を実現できたことが主因。7 月からの 3 カ月間で、顧客のテスト項目やテストタイムに大きな変化があったとはみていない。顧客は短いサイクルで半導体開発をしており、今後どのようにテストタイムが変化するのかは、推測が難しい。

[HBM 向けメモリ・テスト]

Q11: 競合他社は HBM 向けテストの売上が来年減少すると考えているが、御社にも当てはまるか。もし当てはまらない場合、HBM 向けでもシェアを伸ばしているということか。

A11: メモリ・テストについては、HBM 向けが減速するとは認識しておらず、どちらかという成長を見込んでいる。HBM の世代交代に伴い、DRAM 容量増とスタック数の増加が当社に恩恵をもたらす見通し。

Q12: HBM 向けメモリ・テストの収益性改善状況を確認したい。また、御社の競合他社がスタック後の HBM テスト工程に製品供給を始めたと聞けが、御社の収益性への影響はあるか。

A12: 収益性向上に向けて、既存設備に対する仕様アップグレードの提案などを進めている。今後 HBM の世代交代が進む中で、顧客は既存テストの構成をアップグレードすることで、技術進化に伴うテストカバレッジ拡大、入念なテストの実施が可能となる。テストの付加価値が高まることでテストの収益性向上につながると考えている。顧客によってアップグレードの適用タイミングは異なるため、当初の見込みより収益性向上はスローなペースで進んでいる。

競合他社との競争は常にあるが、当社は顧客に対して、HBM 需要の立ち上がり期よりテストのインストールベースを積み上げてきた。このインストールベースを活用し、顧客と詳細な技術協議を重ね、高いマーケットポジションを維持していきたい。

[中国市場におけるテスト需要]

Q13: 中国市場における半導体テスト需要の先行きに何か変調はあるか。半導体製造装置業界では、中国市場の減速が決算数字に顕在化している企業もある。また、中国向けテストは主にモバイル向けか、もしくは HPC/AI 向けも存在するのか。

A13: 他社についてのコメントは控える。当社では、中国ビジネスにおいて大きな変化が起きている認識はない。中国向け SoC テスタは、モバイル向けだけではなく、車載関連向けなどでもご利用いただいている。加えて、中国でのメモリ半導体ファブはますます拡大しており、メモリ・テストのビジネスも並行して行っている。このように、中国市場では広範囲な領域でバランス良く当社のテストをご利用いただいている。

[AI 関連以外のテスト需要回復見通しとテスト供給能力]

- Q14: スマートフォン向けなど、AI 関連半導体以外のテスト需要の回復の見通しはどうか。また、需要回復時に御社の供給体制に問題はないか。
- A14: 2025 年のスマートフォン市場回復に期待している。足元で回復の兆しが出ているのはエッジ AI。エッジ AI はスマートフォンとパソコンなどで採用されつつあるが、まだ買い替え需要を喚起するには至っていない。また供給体制について、当社は HPC/AI 関連だけではなく、エッジ AI 関連向け半導体テストにも供給可能な能力を有している。

[株主還元方針]

- Q15: 株主還元の方針について。来年度も増収増益になった場合、自己株式取得の枠組みはどうか。
- A15: MTP3 期間(2024 年度～2026 年度)の 3 年間合計で、総還元性向 50%以上を目途とすることが方針。株主への還元は配当もしくは自己株式取得を通じて検討すべき事項である。一方で、適正な現預金水準を確保しつつ、コア・ビジネスや周辺ビジネス拡大に向けた投資も着実に進めていきたい。成長投資の機会には借入も選択肢の一つになる。

[成長投資]

- Q16: 現在の市場動向を見たときに、御社が成長投資をすべき領域はあるのか？
- A16: 半導体の複雑性が増すトレンドにおいて、テストソリューションの強化が注目領域である。例えば、当社が持っていない技術の獲得、パートナー企業への投資、当社の供給能力強化など。当社は常に候補先を検討している。これ以上の詳細は控えたい。

以上

※本資料に記載されている内容は、決算説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。